

# 華邦新聞

## 公司新聞

### 華邦打造新佈局為交棒、傳承作準備

**Jun/10/2005**

(台北訊) 華邦電子股份有限公司於六月十日董事會中通過重要人事案，董事會除選任焦佑鈞為董事長和章青駒為副董事長外，公司並增設「執行長」及「副執行長」職務，由焦佑鈞董事長擔任執行長，章青駒副董事長擔任副執行長。章青駒副董事長原擔任之總經理職務將於今年八月一日後卸任，遺缺將晉升原邏輯產品事業群徐英士副總經理為公司總經理。

華邦公司表示，現任總經理章青駒博士自 1999 年 1 月接任總經理以來，建立管理制度，培育經營人才，調整業務內涵，為公司奠定了穩固的營運基礎。並成功帶領華邦記憶體事業由商用型 DRAM 轉型至利基型 DRAM，績效卓著。章博士擔任公司之副董事長兼副執行長，未來除了繼續襄助公司營運外，亦將繼續主掌公司之技術開發、知識管理及財務管理等重要領域，以強化華邦公司未來營運體質及競爭力。

新任總經理徐英士先生，將負責公司整體營運任務。徐博士畢業於台大電機系及台大電機研究所，隨後赴美深造並獲得美國南加州大學電機工程博士學位。徐博士曾經任職於工研院電子所、華邦電腦產品事業處處長、華邦銷售中心協理、副總經理及華邦邏輯產品事業群副總經理。徐博士不但學養俱佳，尤其在產品開發和業務行銷領域擁有豐富經驗，是華邦長期培養的新世代領導人之一。

徐英士先生在當選為新任總經理後表示：展望公司的營運發展，將以客戶為導向，品質為基礎，速度為手段，效率為目標。

在邏輯產品事業群方面，公司將更加聚焦於現有產品基礎及發揮產品間之綜效，除了近日取得美國國家半導體先進電腦事業處，提升華邦在筆記型電腦和伺服器市場之先進系統解決方案外，在原有的產品線包括消費性電子、電腦及網路通訊等，亦將持續加強產品的競爭力以滿足客戶的需求。在記憶體產品方面，未來在中科 12 吋廠建廠完成，並開始投片試產後，預計對於華邦記憶體產品事業群的營運將會如虎添翼，且將更有助於華邦達成「行動記憶體產品解決方案」(Mobile Memory Solution) 之目標，以滿足客戶在行動電子產品應用端的需求。

在充滿挑戰的半導體產業，此一重要人事佈局，意味著公司經營階層交棒與傳承的漸進展開，在現有堅強經營團隊及厚實產業實力基礎下，華邦已啟動另一事業高峰之成長動力。

## 華邦新聞

### 公司新聞

#### 華邦電子董事會通過詹東義先生出任總經理

Feb/06/2009

華邦電子股份有限公司於今日(二月六日)上午召開董事會，董事會相當肯定詹東義先生過去在華邦任職期間戮力拓展公司業務，以及對協助公司營運成長有相當顯著的貢獻，因此通過回聘詹東義先生擔任總經理乙職，此項任命案預計將於 2 月 9 日起正式生效。現任副董事長兼總經理章青駒先生，於免兼總經理職務後則專任該公司之副董事長兼副執行長，襄助執行長擘劃相關之公司營運策略。

詹東義先生為美國加州大學柏克萊分校電機碩士及博士，同時為美國史丹佛大學管理碩士；在加入華邦之前，詹東義先生曾於美國 Intel、Cypress、Siliconix 等公司服務多年，在產品技術開發的領域上經驗豐富；自 1995 年至 2000 年於華邦任職期間，曾經先後擔任華邦美國子公司研發處長、非揮發性記憶體 (NVM) 產品中心協理、及華邦美國子公司總經理等職務，主要肩負華邦 NOR 型快閃記憶體產品線開展之重責，詹東義先生建立並帶領 NVM 團隊，從研發技術紮根、行銷業務開發、到成功將產品導入市場，對華邦公司在快閃記憶體市場的營運成長，有相當顯著之貢獻；2000 至 2005 年轉而出任華邦總公司技術副總監和銷售業務副總經理等職務，持續協助公司開展產品及銷售市場不遺餘力；爾後於 2005 年 10 月請辭，轉戰上海擔任 BCD Semiconductor 執行長一職。

華邦表示，經過十餘年來的努力，華邦已在快閃記憶體領域佔有重要一席之地，未來仍將要繼續借重詹東義先生在產品技術和業務行銷領域之專才，進一步增強華邦在 NOR Flash 領域的核心戰鬥力，詹東義先生其跨足 DRAM 和 NOR Flash 二大領域的營運管理經驗，對目標全力以赴的領導風格和宏觀的國際視野，將持續提升華邦作為領導地位的 Specialty DRAM

和 NOR Flash 供應商，為公司營運成長開創另一番嶄新契機。

華邦電子以專業的記憶 IC 公司為定位，且將經營資源集中於有競爭力的市場。在 DRAM 領域方面，65 奈米 Buried Wordline DRAM 製程技術已成功移轉並進入量產階段，未來公司將利用該技術發展低耗電行動記憶體，同時致力縮短生產週期，降低生產成本，即時掌握市場變化，以滿足客戶導向的應用需求，維持最佳競爭優勢；在 NOR Flash 領域，不論是在 Parallel Flash 或是 Serial Flash 皆有完整佈局，目前 90 奈米製程技術已成功開發並於第一季導入十二吋廠試產，將可提供電腦、消費性和通訊領域客戶更完整及具價格競爭力的儲存解決方案。